

开放共创**AI Infra**未来

Open AI Infra 社区 2026 年全年活动规划

王海峰
Open AI Infra社区副秘书长

一、社区活动总览

二、核心品牌会议

三、技术专题沙龙

四、专家探营活动

五、社区线上直播

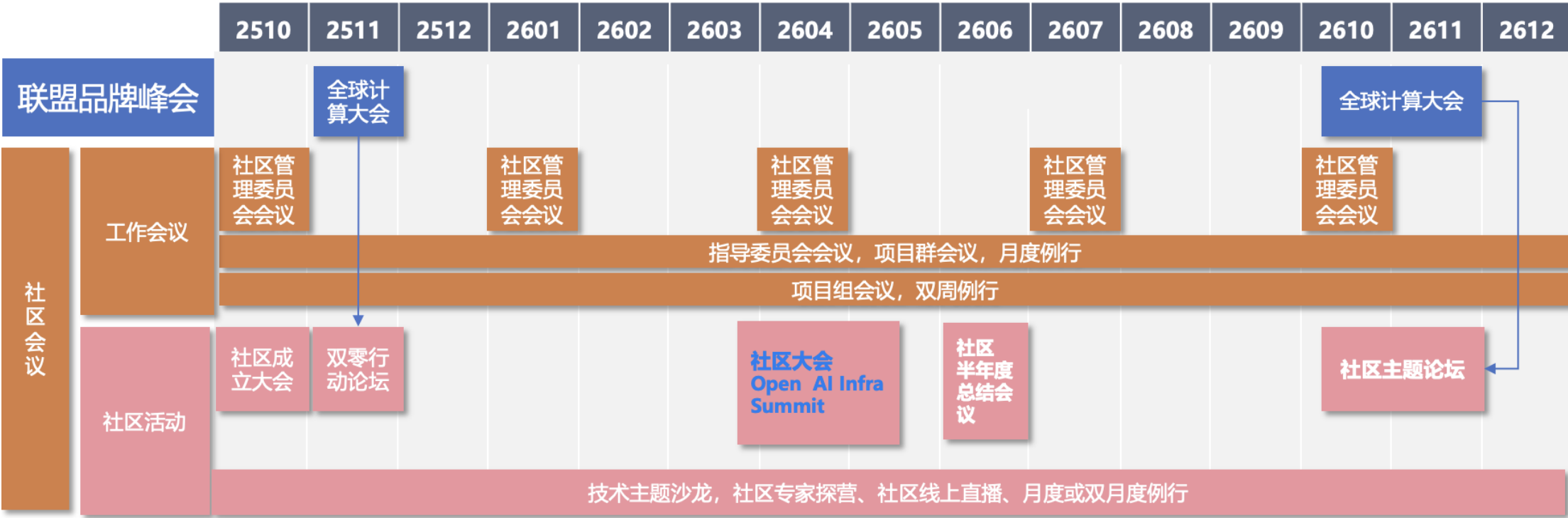
六、合作伙伴权益

一、社区活动总览

核心方向：围绕**技术研讨**、**项目落地**、**生态共建**，开展全年体系化活动

核心目标：凝聚产业力量，推动 AI 算力设施技术创新与规模化落地

活动特点：常态化、专业化、场景化、落地导向



二、社区核心品牌会议



主要内容：落地引领：以开放社区模式协同，加速硬件创新与技术迭代，快速响应AI需求，推动行业规范落地与优化。

技术洞察：搭建技术研讨平台、聚焦面向未来的算力架构创新，MW级算力系统、800V供电散热等新技术。

生态共建：从应用需求到芯片、算力架构、基础设施全栈生态伙伴融合共创，搭建需求对接、成果共享平台。

组织形式：社区共创，由工作组组长与社区用户专家担任论坛主席，定义会议内容，秘书处协助落地，保障会议高效落地

类别	活动名称	时间	地点	规模和介绍
品牌峰会	社区大会 Open AI Infra Summit 2026	2026年 4月9日-10日	北京	• 规模：1500人+ • 定位：社区年度大会+6大主题论坛 • 主要内容：高速互联、800V、全栈液冷、超节点生态、G瓦级AIDC、超节点性能
	超节点、GW级AIDC技术论坛 社区2026年半年度总结会议	2026年 7月3日	北京	• 规模：200-300人（成员报名 + 审核制） • 议题：上半年重点项目进展，研讨阶段性成果、技术方向及后续落地计划，重点XPU、高速互联
	AIDC产业发展大会	2026年 9月	上海	• 规模：500-800人 • 议题：围绕AIDC产业上下游发展、散热、800V重点讨论
	全球计算大会2026 & CEIC消费电子创新大会 ·Open AI Infra 论坛	2026年 10月21日	深圳	• 年度双盛会社区主题论坛 • OAI论坛规模400人+，包含超节点、800V、AI算存、全栈液冷等
提前预约	社区大会 Open AI Infra Summit 2027	2027年 3月底或4月初	北京	• 规模：2000人+ • 定位：社区年度大会+6大主题论坛 • 主要内容：以算力为核心，从芯片-服务器-AIDC-园区的全栈成果发布和新技术洞察分享

CEIC 2026创新无限潜能，定义消费电子新风向



CGC 2026 将与CEIC 2026 同期举办，欢迎参加！

CEIC大会定位

亚太科技旗舰盛会

产业创新平台

年度成果展

CEIC大会主题

Innovation for Infinity
爱创新，智无限

Innovation for Tech
创新无限动能

Innovation for Ecos
创新无限边界

Innovation for Life
创新无限可能

CGC 2026 主题

兆瓦启新基，智算赋千业

日程框架

10.21 Web

10.22 Thu

10.23 Fri

10.24 Sat

- ★ 主论坛：2026 全球计算大会
- ★ OAI社区&智算DG：超节点算力生态论坛
- ★ OAI社区：800V高压与下一代算力供电论坛
- 低精度数据格式论坛
- 具身智能与端边云协同创新论坛
- 机密计算与数据安全保障

CEIC 2026开幕式暨主论坛

- 星闪产业峰会
- 网络创新发展峰会
- 创新标准化交流峰会
- 无线局域网应用发展论坛

- 低空经济论坛
- AI终端论坛
- 鸿蒙大会
- 高清音视频论坛

展览展示



大会官网二维码
欢迎报名参会

三、技术专题沙龙

场次	活动名称	时间	地点	规模 and 介绍
1	兆瓦级算力系统沙龙	2026年1月23日	北京	兆瓦级算力系统算力单元、高速互联、供电等方面探讨 (100+)
2	NPO光互联项目筹备会	2026年6月4日	上海	芯片和服务：未来一两代的规划，特别是单机柜的功率需求 (80+)
3	XPU模组项目筹备会	2026年6月上旬	上海	满足接口规范与定制化的应用需求 (100+)
4	DC800V 技术沙龙	2026年7月2-3日	北京	从芯片、板级、机柜、基础设施、园区全链路供电探讨 (150+)
5	超节点与算电协同	2026年7月17日	上海	实现算力密度、硬件兼容性与部署灵活性的最大化平衡 (100+)
6	AI存储项目组（筹）算存融合技术沙龙	2026年7月16日	上海	GPU直连效率、存算融合深度、AI SSD性能优化等关键技术瓶颈 (100+)
7	散热、液冷技术沙龙	2026年8月	北京	从机柜内到基础设施、工质液等全栈新技术、新架构、新方案 (150+)
8	超节点、DC800V等主题研讨会	2026年9月	北京或上海	超节点内算、存、网、DPU等 (80+)
9	兆瓦级算力系统、G瓦级AIDC等	2026年10月	深圳	兆瓦级算力系统算力单元、高速互联、散热、供电等方面探讨 (100+)

备注：话题可根据社区成员建议增加修改，参会成员以社区用户、技术专家为主，采用资源报名、审核通过制

四、社区专家探营

- 探营规模：20--30人等不同规模
 - 沙龙定位：技术落地实践考察与技术研讨
 - 主要内容：围绕《AIDC基础设施规范》落地成果，考察AIDC样板点建设和运行情况
- 围绕社区项目以及先进技术落地、如800V工厂、液冷技术、双零行动、高速互联等深入考察研讨

类别	时间	地点	主题内容	参与形式	备注
专家探营	2026年7月	长三角	AIDC样板点、供电、高速互联或液冷工厂、实验室考察	参观、专家探讨	可根据社区情况酌情更新
	2026年9月	京津冀内蒙	AIDC样板点	参观、专家探讨	
	2026年11月	大湾区	制冷、供配电生产、应用考察	参观、专家探讨	
	2026 Q4	马来西亚、泰国	企业出海，数据中心、技术落地考察	参观、专家探讨	

五、社区线上直播

- 直播内容：社区技术解读、项目进展、专家对话、互动答疑。
- 直播平台：社区视频号、益企研究院视频号等多平台推流
- 内容传播：直播结束后视频回放、直播内容文字整理刊发

场次	活动名称	时间	介绍
1	800V供配电	2026年3月	从芯片、板级、机柜、基础设施全链路供电探讨
2	高速互联	2026年3月	光互联、电互联的技术演进和发展
3	散热液冷	2026年6月	从机房到基础设施散热新技术，新架构新方案
4	AI算存融合	2026年7月	存算深度融合，AI SSD 性能优化等
5	微模块供配电	2026年7月	社区成果解读，微模块供电设计、演进及部署
6	XPU模组	2026年8月	实现算力密度、硬件兼容性与部署灵活性的最大化平衡
7	800V供配电	2026年9月	社区成果解读，从园区到柜内供配电全链路探讨
8	双零行动	2026年10月	机房部署零等待、液冷落地零问题为目标，工质液等等问题

开放共创**AI Infra**未来
2026 Open AI Infra Summit回顾

整体情况概述



定位/价值

 大会定位：面向AI Infra领域的产业交流、成果发布与生态协同平台型大会。  价值：全面实现“议题引领、成果发布、产业连接、生态协同”的核心目标。

大会日程



1个主论坛 +



高速互联



800V供配电



全栈液冷



6个主题技术论坛 +



30个展点 +



8个社区交流会 +



1个交流晚宴

整体参会规模

1500+	1000+	220+	200+	7200+
两日实际到场参会嘉宾	主论坛到场人数	800V供配电论坛到场人数 (分论坛人气Top)	高速互联&全栈液冷到场人数 (分论坛人气Top2)	主论坛直播线上观看人数

日程完整

- 全维度核心议题覆盖
- 前沿技术与实战经验双重赋能

1场主论坛

聚焦战略引领、社区全景发展、社区成员分享三大篇章展开

6个主题分论坛

围绕AIDC关键方向展开讨论。完整覆盖高速互联、800V供配电、全栈液冷等关键方向，内容覆盖面广、议题密度高

8场社区研讨

强化成员互动与业务交流

30家厂商参展

全面集中展示前沿技术与创新产品，提供交流互动场域

阵容强大

- 产学研用多层级重磅嘉宾集聚
- 兼具权威性与产业代表性

1位院士致辞

中国工程院院士郑纬民

90+位产业领袖进行演讲

GCC金海、中移张春、字节高晓军、字节井汤博、华为龙盘、京东云王贵林、阿里云邱宇弟、快手李典林、百度云武正辉、阿里云常存银、京东云金跃红、百度云程冰、字节跳动陈军、字节跳动何佳洸、小红书于亮亮、新华三王锋、世纪互联VP闫昆等

N家头部互联网、运营商、最终用户

字节跳动、阿里云、百度云、京东云、蚂蚁金服、快手、小红书、B站、中国移动、中国电信

13位顾问委员会聘书颁发

85%产业顶尖智力资源到场领奖，凸显社区号召力

37家产业伙伴赞助参与

百度 京东 蚂蚁 曙光 超聚变 新华三 联想等

价值关山

- 9项重磅成果集中发布
- 有规范、有认证、可落地

7项成果发布

- 发布规范：《GCC液冷整机柜系统架构设计规范-A型》、《AIDC基础设施规范》、《冷板液冷系统智能运维技术规范》等
- 发布工具：超节点性能基准Benchmark工具

2个启动仪式

启动AIDC样板点认证项目、兆瓦级算力系统项目。

形式创新

- 全场景品牌视觉统一贯穿
- 仪式感与社区归属感度拉满

1首 AI 主题曲

打造峰会专属听觉标识，培养习惯认知

16座表彰奖杯

致敬深耕社区、倾力奉献的社区伙伴，凝聚生态奋进力量

1纪念帽衫1专属徽章

社区成员归属感、身份认同感；现场别致风景线

1套专属桌布

整个展区贯穿社区logo，打造风格高度统一参会环境；可复用，节约成本+环保

报名/参会人群分析

业务管理运营与技术研发为核心主力，高管及中高级决策人群占比充足，完整覆盖 AI Infra 全产业链



2,147

总报名人数
(截止到4月7日20点)

1,107

到场核销人数
(剔除特邀VIP、工作人员、未记名参会嘉宾)

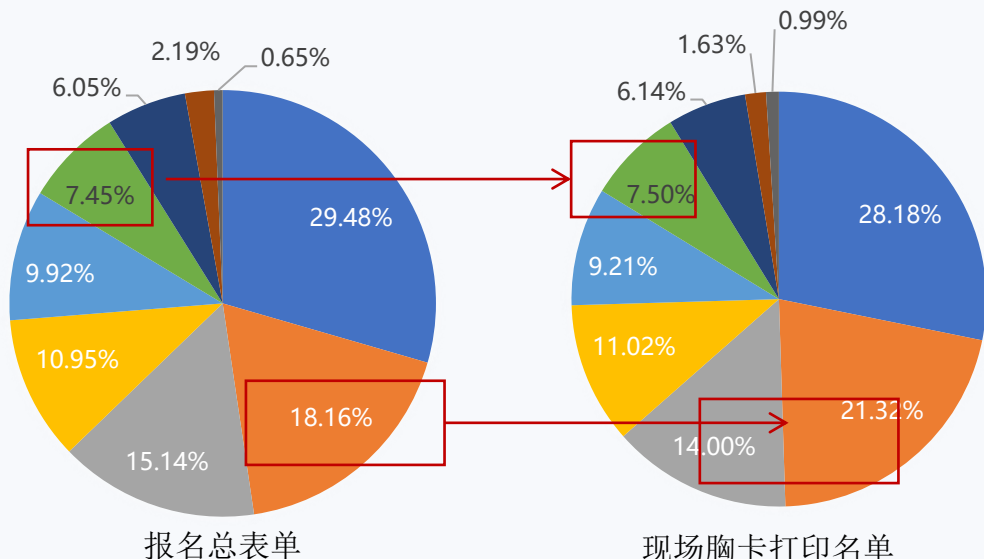
1,500+

到场人数
(如重要嘉宾、空降、临时增加客户等)

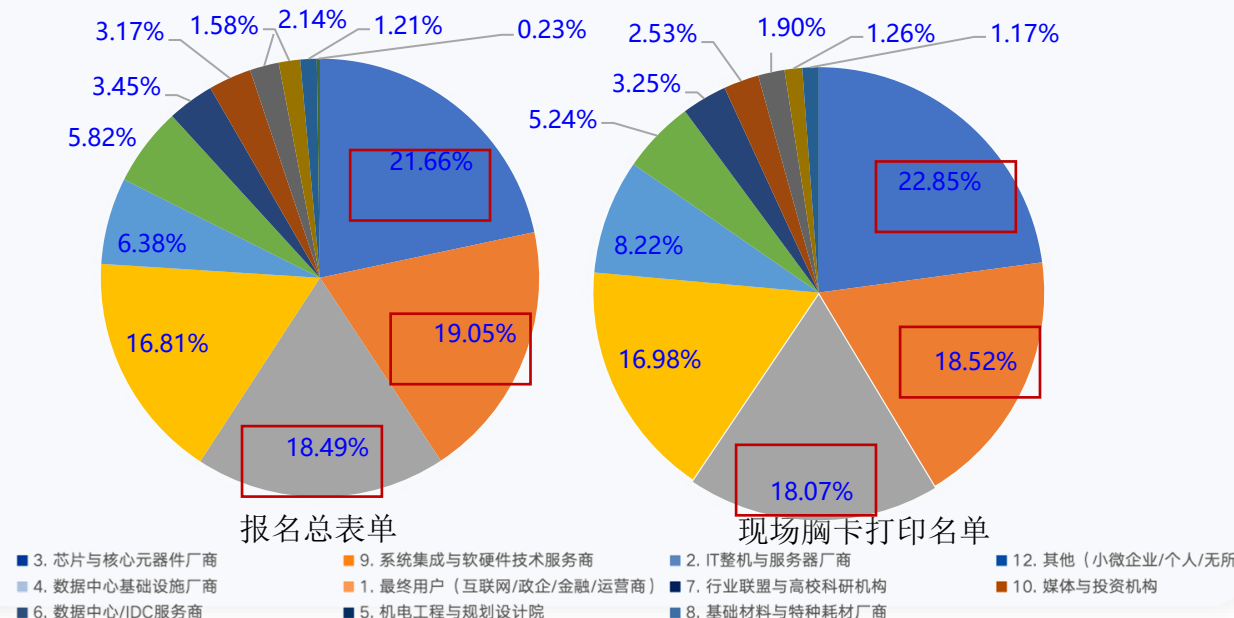
51.6%

整体到场率
(报名 -> 核销)

按职务划分



按企业属性划分



到场率与人群质量双高

·到场率超51%，在大型行业会议中处于较高水平；
·**技术岗 (产品工程研发 + 资深研发专家)：现场占比28.82%**，显著高于报名占比25.61%，技术人群到场意愿突出；



参会人群职务分布均衡 覆盖全产业链决策链条

到场人群中，业务管理与运营执行层占比28.18%，技术研发核心群体占比28.82%，高管 + 中高级管理层现场合计占比23.21%，分别覆盖实际业务落地、技术、战略决策视角。



参会企业AI Infra 产业链高度集聚 全生态覆盖

无论是报名、还是现场到场人群内，芯片元器件、IT 整机服务器、系统集成服务商为现场三大核心，合计占比超50+；

2026 Open AI Infra Summit 同期展览

建圈子，树标杆，扩大社区影响力

- ✓ 首届集结**30家**全栈生态伙伴，覆盖上下游核心环节，参会者一站式看清产业全貌

现场沟通，实物展示，体现专业度

- ✓ 每家展台都进行了实物展示，以及方案，也都派出了专业人员进行展台讲解

现场直播，探展视频，提升传播力

- ✓ 在4月9日进行了展台直播，同期对部分展台进行了探展视频拍摄，由展台人员进行详细讲解，提升了传播影响力



传播数据

01

官方传播矩阵：原创内容**60+**篇，官网、知乎、企鹅、头条、搜狐全渠道持续更新，累计发布频次**260+**，累计阅读量**15W**，官网活动页访问1.6W+，直播3场：

02

生态伙伴联动：联动华为、阿里云、Solidigm、超聚变、新华三、施耐德、英维克、维谛、立讯技术等产业伙伴，发布相关预热**20+**条

03

专业媒体报道：获中国日报、新华社、新浪财经、中国网、中国工业报等媒体报道，累计获报道**50+**篇，20家媒体到场参会，截止目前发稿13篇（其中**4篇原创，1条vlog**）

价值亮点

01

专业内容沉淀：大会期间共**20**探展视频、**15**专访视频、**20+**COMPUWAVE文章，供会后长效传播，构建品牌专业影响力

02

参会转化赋能：通过直播、EDM、KOL、产业伙伴发文吸引报名，助力大会客邀

03

权威渠道利用：定向邀请权威媒体出席、发稿实现宣传，充分利用自有渠道，保障主流搜索引擎及AI收录





Global Computing Consortium

全 球 计 算 联 盟

Thank You !